

Pressemitteilung

29/11/2010

AT&S führt neue Technologie in den Markt ein

Sie werden immer kleiner und multifunktioneller – die Geräte der Zukunft. Effizientere Platznutzung wird damit für die Hersteller eine absolute Notwendigkeit. Die neue Entwicklung im Bereich der Leiterplatten schafft Platz im kleinsten Gerät: die „Embedded Component Packaging“ Technologie (ECP®), die von AT&S patentiert wurde ermöglicht eine effiziente Miniaturisierung bei gleichzeitiger Leistungserhöhung von Geräten.

„AT&S hat die wesentlichen Fertigungsprozesse der ECP® selbst entwickelt und industrialisiert“, erklärt CEO Andreas Gerstenmayer, AT&S. „Besonders freut es uns, dass wir sehr anspruchsvolle Kunden von unserer neuen Technologie überzeugen konnten - wie z.B. Texas Instruments.“ AT&S beschäftigt sich bereits seit fast zehn Jahren mit der Idee der Einbettung aktiver und passiver elektronischer Komponenten in die Leiterplatte und hat daher gegenüber den Mitbewerbern eine starke Position.

ECP® ist eine höchst effiziente Technologie zur Einbettung von aktiven und passiven elektronischen Komponenten in eine Leiterplatte. Generell wird sie in Produkten zum Einsatz kommen, wo sehr viele Features auf kleinstem Platz benötigt werden. Ziel ist es, entweder die Größe der Haupt-Leiterplatte durch die Integration ausgesuchter elektronischer Komponenten zu reduzieren oder durch die Integration Platz auf der Leiterplattenoberfläche zu schaffen, um zusätzliche Komponenten und somit Zusatzfunktionalität zu ermöglichen. Ein zweiter Anwendungsbereich sind die elektronischen Komponenten selbst. Ein Chip besteht herkömmlich aus einem Halbleiterkern der entsprechend „verpackt“ werden muss, um auf eine Leiterplatte aufgesetzt werden zu können. ECP® bietet hier eine effiziente Alternative zum herkömmlichen Chip Packaging und erlaubt wiederum Größenreduktion bei gleichzeitiger Leistungserhöhung des Chips.

Neben der Möglichkeit neue Produktgenerationen mit dieser Technologie für bereits bestehende Kunden zu realisieren, hat sich in den vergangenen beiden Jahren gezeigt, dass dieser Ansatz besonders revolutionär für die Halbleiter- / Chip-Industrie ist, was für AT&S ein komplett neues Marktsegment bedeutet. Die Kombination der Wertschöpfungserhöhung durch den Einbau von Komponenten plus Erschließen eines neuen Marktes ist für die AT&S ein vielversprechendes Wachstumsszenario.

Über AT&S

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der leistungsstärksten Leiterplattenproduzenten. Insbesondere im höchsten Technologiesegment, den HDI-Microvia-Leiterplatten, welche vor allem in Mobile Devices zum Einsatz kommen, ist AT&S weltweit bestens positioniert. Erfolgreich ist der Konzern auch im Segment der Automotive-Leiterplatten sowie im Industrie- und Medizintechnikbereich tätig. Als internationales Wachstumsunternehmen verfügt AT&S über eine globale Präsenz mit drei Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring, Klagenfurt) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai) und Korea (Ansan nahe Seoul). Weitere Infos auch unter www.ats.net.

Presserückfragen:

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

Martin Theyer | Director Strategy Development & Communications | +43 3842 200-5909 | m.theyer@ats.net